

教育機関提出用 インターン関連情報

フェイスシート

項目	記載欄
企業名	アルプスアルパイン株式会社
事業所所在地	東京都大田区雪谷大塚町1-7
WEBサイト	https://www.alpsalpine.com/j/
業種	電子部品・車載情報機器製造
事業内容	自動車・家電製品・情報通信機器・ゲーム・スマートフォン・PC・モバイル機器など、幅広い分野の機器に搭載され、人々の暮らしの快適性・利便性を担っています。 ビジネス・フィールドは日本を核に、欧州・米国・アジア地域などに製造・販売拠点を展開。技術力、製品品質、そして環境への配慮など、そのいずれでも世界をターゲットとした目標を掲げ、事業展開を推進しています。

インターン内容

項目	記載欄
実施場所	仙台開発センター(古川) 宮城県大崎市古川中里
実施形態	リアル
受入期間	2024年1月15日(月)～ 当社指定 別途、2～3月で実習@東北大(2日間)について調整中
受入日数	2週間 (東北大実習込の場合は1週間)
受入人数	5名程度
実施時間	8:20～17:00
体験業種	開発設計
主な体験内容	開発・設計・評価・企画の半導体業務全般の説明をお聞きいただき、それ以降で各パートを体験していただけます。 *体験内容に、東北大学の施設を活用した半導体製造工程体験実習を含む場合有り(調整中)。詳細が確定しました。
ポイント	半導体設計現場のエンジニアが必ずおり、当社の設計環境に触れることができます。
受入条件	・理工系専攻の大学生(2/3年)・大学院生(1年) ・高専生(本科3/4年、専科1年) ・各テーマごとの参加条件有り(要 半導体設計ツールの理解)※応募後、マッチング選考を実施します。詳細は応募者へご連絡いたします。
持参物品、昼食	昼食は当社事業所利用可。(1食500円程度)
申込開始日	2023/12/1
申込締切日	2024/3/31
実施プログラム	※各テーマによりプログラムは異なります。 テーマ① アナログ半導体設計及び検証 テーマ② デジタル半導体設計及び検証 テーマ③ 半導体検査及び半導体不良解析
交通・宿泊等に関する	交通費/宿泊費は当社規定額をお支払いします。